

LS Series

Dry process at high through put.

ハイスループット、ドライプロセスを実現。

The substrate is cut after firing using a high-speed, dry process, giving substantial productivity improvement.

(Eliminates the need for a V-groove cutting and beveling in conventional post-processing)

"Spline Scribe function" is available to measure and cut strained ceramics automatically.

In addition to LTCCs, this compact scriber can cut glass substrates and other brittle materials (AlN, Ferrite and so on) up to 300mm square.

「焼成後」の基板を、高速度のドライプロセスで分断加工することにより大幅な生産性向上を実現。

(V溝付けや研磨といった従来の後工程を省略)

歪スクライブ機能により焼成後の歪んだ基板にも対応。

LTCC以外にも300mm角以下のガラス基板、脆性材料の分断も対応可能。



The outside appearance and specifications are subject to change without notice.

外観、仕様は予告なしに変更になることがあります。

LS Series

LS Specifications

Substrate Thickness	対応基板厚み	0.4mm-1.1mm
Substrate Size	対応基板サイズ	270×270mm MAX
Scribe Velocity	スクライブ速度	500mm/sec MAX
Scribe Accuracy	スクライブ精度	Straight Scribe / 直線 ±20μm

MDI New Process

MDI scribing technology has simplified LTCC substrate separation process

Typical LTCC cutting process



MDI new process



LTCC 分野においても、分断工程の簡素化を実現しました

現状の主な LTCC 分断工程 (例)



MDI 新プロセス LTCC 熟成後の分断方法



Applications

LTCC, other electric components.

Contact

www.mitsuboshidiamond.com

※Trademarks and registered trademarks used herein are the property of their respective owners.
 ※本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

※The specs are subject to change without prior notice.
 ※記載された仕様は予告なく変更することがあります。